

参考出品

挿入(スルホール)部品・取外し支援装置 IR 局所リワークシステム・IRX-1

鉛フリー
実装基板用



溶融ハンダを使わない新しいリペアシステム登場！

銅喰われしないので基板ランドにダメージを与えず安全な作業が可能！

局所噴流式のリワークシステムと異なり、溶融ハンダを使用しないので銅喰われによるパターン損傷、ランド剥離などのトラブルがなく、安全な取り外し作業が可能。

SMDリワーク装置で使用する熱風ノズルが不要なため、素早い段取り替えが可能であると同時に部品ごとに数種類のノズルを用意する必要がないので経済的。

非接触温度センサーにより、加熱スポットの温度プロファイルを測定しながらリワークするので、基板および部品に対して安全な除去作業が可能。

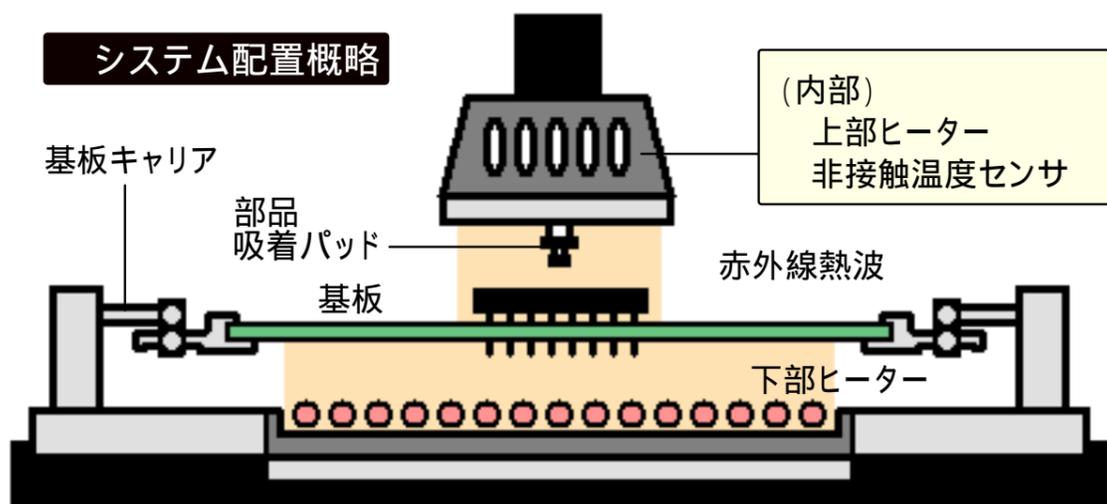
加熱源には新開発のディフューズ・ラジアントIR(浸透力の高い波長を持った赤外線)方式のヒーターを採用 基板にやさしく、同時に効率の良いリワークが可能。



主な仕様

対応部品サイズ	120 × 80mm以内 (リードが直線的に挿入されているもの)
対応基板	MAX : 300 × 400mm
電源・消費電力	単相 200V 約1.8kw(最大)
使用空気圧	0.4 ~ 0.6mpa
加熱源	IR (ディフューズラジアント式) ヒーター
本体寸法	(幅) 620 × (奥行) 650 × (高) 500mm
本体重量	約45kg

システム配置概略



取外し部品例

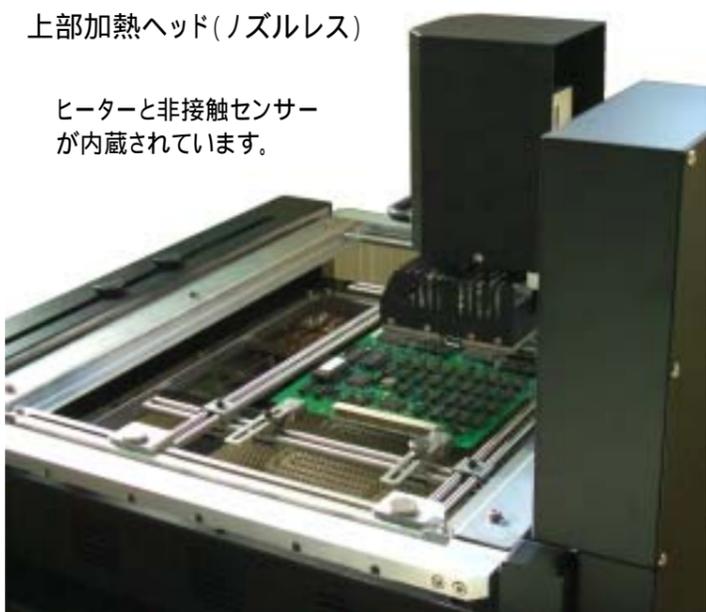
基板穴に対してリードがストレートに挿入されていれば多列・多ピン部品でも問題なくスムーズな取外しが可能です。



上部ヒーターの熱で損傷が懸念される部品(右上のコネクタ)に対しては加熱時間を多少延長し下部ヒーターのみで除去します。

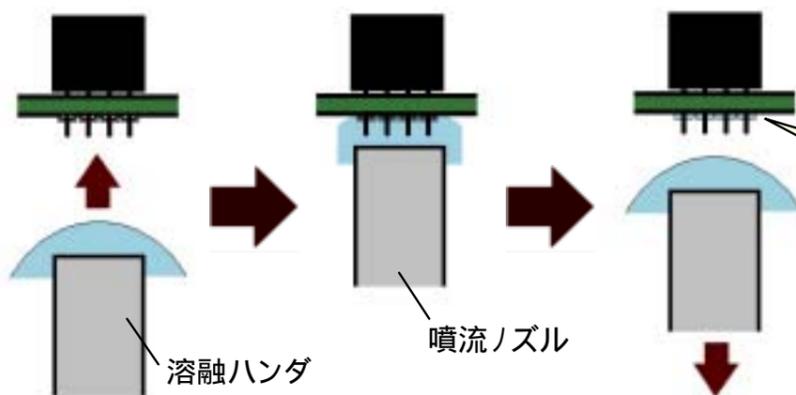
上部加熱ヘッド(ノズルレス)

ヒーターと非接触センサーが内蔵されています。



局所噴流ハンダ槽による作業のトラブル

従来より溶融ハンダを局部的に噴流させて部品を取り外す方法が一般的に多く用いられてきましたが、鉛フリーは融点も高く、再溶融させるためには大きな熱量が必要となるため、多層板や放熱量の大きな部品が実装されている電源基板などは部品を取り外す前に基板の銅ランドが消失するなどのトラブルが先に発生してしまいます。鉛フリーは錫(Sn)が成分の多くを占めるため、特に銅喰われが激しくなる傾向にあり、十分な注意が必要です。



- 銅喰われによるトラブル
- ・ランド(パターン)細り
 - ・ランド(パターン)消失
- 高温作業によるトラブル
- ・ランド剥離
 - ・スルホールクラック
 - ・レジクラック
 - ・スルホール断線

基板キャリアと基板ホルド爪 スムーズな動きのバーで自由に幅調整が可能です。

